

2024-2030年中国芯片行业 前景展望与发展趋势研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国芯片行业前景展望与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/416503.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

芯片（半导体元件产品的统称），集成电路，缩写作 IC；或称微电路、微芯片、晶片/芯片在电子学中是一种将电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）小型化的方式，并时常制造在半导体晶圆表面上。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片行业前景展望与发展趋势研究报告》共八章。首先介绍了芯片行业市场发展环境、芯片整体运行态势等，接着分析了芯片行业市场运行的现状，然后介绍了芯片市场竞争格局。随后，报告对芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片产业有个系统的了解或者想投资芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 中国芯片行业发展综述

1.1 芯片行业概述

1.1.1 芯片的定义分析

1.1.2 芯片制作过程介绍

（1）原料晶圆

（2）晶圆涂膜

（3）光刻显影

（4）掺杂杂质

（5）晶圆测试

（6）芯片封装

（7）测试包装

1.1.3 芯片产业链介绍

（1）产业链上游市场分析

（2）产业链下游市场分析

1.2 芯片行业发展环境分析

1.2.1 行业政策环境分析

（1）行业标准与法规

(2) 行业发展政策

(3) 行业发展规划

1.2.2 行业经济环境分析

(1) 国民经济运行状况

(2) 工业经济增长情况

(3) 固定资产投资情况

(4) 经济转型升级形势

(5) 宏观经济发展趋势

1.2.3 行业社会环境分析

(1) 互联网加速发展

(2) 智能产品的普及

(3) 科技人才队伍壮大

1.2.4 行业技术环境分析

(1) 技术研发进展

(2) 无线芯片技术

(3) 技术发展趋势

1.3 芯片行业发展机遇与威胁分析

第二章 全球芯片所属行业发展状况分析

2.1 全球芯片行业发展状况综述

2.1.1 全球芯片行业发展历程

2.1.2 全球芯片市场特点分析

2.1.3 全球芯片行业市场规模

2.1.4 全球芯片行业竞争格局

2.1.5 全球芯片行业区域分布

2.1.6 全球芯片行业需求领域

2.1.7 全球芯片行业前景预测

2.2 美国芯片行业发展状况分析

2.2.1 美国芯片市场规模分析

2.2.2 美国芯片竞争格局分析

(1) IC设计企业

(2) 半导体设备厂商

(3) EDA巨头

(4) 第三代半导体材料企业

(5) 模拟器件

2.2.3 美国芯片市场结构分析

2.2.4 美国芯片技术研发进展

2.2.5 美国芯片市场前景预测

2.3 日本芯片行业发展分析

2.3.1 日本芯片行业发展历程

(1) 崛起：2020年s，VLSI研发联合体带动技术创新

(2) 鼎盛：2020年s，依靠低价战略迅速占领市场

(3) 衰落：2020年s，技术和成本优势丧失，市场份额迅速跌落

(4) 转型：2020年s，合并整合与转型SOC

2.3.2 日本芯片市场规模分析

2.3.3 日本芯片竞争格局分析

(1) 日本材料半导体

(2) 日本半导体设备

2.3.4 日本芯片技术研发进展

2.3.5 日本芯片市场前景预测

2.4 韩国芯片行业发展分析

2.4.1 韩国芯片行业发展历程

(1) 发展路径

(2) 发展动力

1) 政府推动

2) 产学研合作

3) 企业从引进到自主研发

2.4.2 韩国芯片市场规模分析

2.4.3 韩国芯片竞争格局分析

2.4.4 韩国芯片技术研发进展

2.4.5 韩国芯片市场前景预测

2.5 中国台湾芯片行业发展分析

2.5.1 中国台湾芯片行业发展历程

(1) 萌芽期（1964-1974年）

(2) 技术引进期 (1974-1979年)

(3) 技术自立及扩散期 (1979年至今)

2.5.2 中国台湾芯片市场规模分析

2.5.3 中国台湾芯片竞争格局分析

2.5.4 中国台湾芯片技术研发进展

2.5.5 中国台湾芯片市场前景预测

2.6 其他国家芯片行业发展分析

2.6.1 印度芯片行业发展分析

2.6.2 英国芯片行业发展分析

2.6.3 德国芯片行业发展分析

(1) 德国芯片行业发展现状

(2) 德国芯片技术研发进展

2.6.4 瑞士芯片行业发展分析

第三章 中国芯片所属行业发展状况分析

3.1 中国芯片行业发展综述

3.1.1 中国芯片产业发展历程

3.1.2 中国芯片行业发展地位

3.1.3 中国芯片行业市场规模

3.2 中国芯片市场格局分析

3.2.1 中国芯片市场竞争格局

3.2.2 中国芯片行业利润流向

3.2.3 中国芯片市场发展动态

3.3 中国量子芯片发展进程

3.3.1 产品发展历程

3.3.2 市场发展形势

3.3.3 产品研发动态

3.3.4 未来发展前景

3.4 中国芯片产业区域发展动态

3.4.1 湖南

(1) 总体发展动态

(2) 细分优势明显

(3) 未来发展前景

3.4.2 贵州

3.4.3 北京

(1) 总体发展动态分析

(2) 北设计——中关村

(3) 南制造——亦庄

3.4.4 晋江

(1) 晋华项目落地

(2) 安芯基金启动

(3) 发展芯片行业的优势

1) 交通便利区位优势明显

2) 政策扶持惠企引才并重

3) 科创体系形成产业支撑

4) 配套完善建设宜居城市

3.5 中国芯片产业发展问题分析

3.5.1 产业发展困境

3.5.2 开发速度放缓

3.5.3 市场垄断困境

(1) 芯片垄断现状

(2) 芯片垄断形成原因

3.6 中国芯片产业应对策略分析

3.6.1 企业发展战略

3.6.2 突破垄断策略

3.6.3 加强技术研发

第四章 芯片行业细分产品市场分析

4.1 芯片行业产品结构概况

4.1.1 芯片产品类型介绍

4.1.2 芯片产品结构分析

4.2 LED芯片市场分析

4.2.1 LED芯片发展现状

(1) LED芯片材料选择

- (2) LED芯片涨价由RGB向白光蔓延，结构型供需失衡显现
- (3) 价格战挤出效应明显，行业竞争格局改善
- (4) 台厂聚焦四元芯片市场，GaNLED产业中心向大陆转移加速

4.2.2 LED芯片市场规模

4.2.3 LED芯片竞争格局

- (1) 国际竞争格局

- (2) 国内竞争格局

4.2.4 LED芯片前景预测

4.3 SIM芯片市场分析

4.3.1 SIM芯片发展现状

4.3.2 SIM芯片市场规模

- (1) SIM芯片整体出货量

- (2) NFC类SIM卡出货量

- (3) LTE类SIM卡出货量

4.3.3 SIM芯片竞争格局

4.3.4 SIM芯片前景预测

4.4 移动支付芯片市场分析

4.4.1 移动支付芯片发展现状

- (1) 移动支付产品分析

- (2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决

- (3) 已有大量POS机支持NFC功能

- (4) 国内供应商开始发力NFC芯片

4.4.2 移动支付芯片市场规模

4.4.3 移动支付芯片竞争格局

4.4.4 移动支付芯片前景预测

4.5 身份识别类芯片市场分析

4.5.1 身份识别类芯片发展现状

- (1) 身份识别介绍

- (2) 身份识别分类

4.5.2 身份识别类芯片市场规模

4.5.3 身份识别类芯片竞争格局

- (1) 国内厂商产能扩大

(2) 缺乏自主知识产权

(3) 安全性尚待加强

(4) 应用尚待开发

(5) 解决方案仍在探索

(6) 上游产能不足

4.5.4 身份识别类芯片前景预测

4.6 金融支付类芯片市场分析

4.6.1 金融支付类芯片发展现状

4.6.2 金融支付类芯片市场规模

4.6.3 金融支付类芯片竞争格局

4.6.4 金融支付类芯片前景预测

4.7 USB-KEY芯片市场分析

4.7.1 USB-KEY芯片发展现状

4.7.2 USB-KEY芯片市场规模

4.7.3 USB-KEY芯片竞争格局

4.7.4 USB-KEY芯片前景预测

4.8 通讯射频芯片市场分析

4.8.1 通讯射频芯片发展现状

4.8.2 通讯射频芯片市场规模

4.8.3 通讯射频芯片竞争格局

4.8.4 通讯射频芯片前景预测

4.9 通讯基带芯片市场分析

4.9.1 通讯基带芯片发展现状

4.9.2 通讯基带芯片市场规模

4.9.3 通讯基带芯片竞争格局

(1) 国际厂商竞争格局分析

(2) 国内厂商竞争格局分析

4.9.4 通讯基带芯片前景预测

(1) 基带和应用处理器融合加深

(2) 价格战将加剧

(3) 工艺决定竞争力

4.10 家电控制芯片市场分析

- 4.10.1 家电控制芯片发展现状
- 4.10.2 家电控制芯片市场规模
- 4.10.3 家电控制芯片竞争格局
- 4.10.4 家电控制芯片前景预测
- 4.11 节能应用类芯片市场分析
 - 4.11.1 节能应用类芯片发展现状
 - 4.11.2 节能应用类芯片市场规模
 - 4.11.3 节能应用类芯片竞争格局
 - 4.11.4 节能应用类芯片前景预测
- 4.12 电脑数码类芯片市场分析
 - 4.12.1 电脑数码类芯片发展现状
 - 4.12.2 电脑数码类芯片市场规模
 - 4.12.3 电脑数码类芯片竞争格局
 - 4.12.4 电脑数码类芯片前景预测

第五章 中国芯片行业产业链分析

- 5.1 芯片设计行业发展分析
 - 5.1.1 产业发展历程
 - 5.1.2 市场发展现状
 - 5.1.3 市场竞争格局
 - 5.1.4 企业专利情况
 - 5.1.5 国内外差距分析
- 5.2 晶圆代工产业发展分析
 - 5.2.1 晶圆加工技术
 - 5.2.2 国外发展模式
 - 5.2.3 国内发展模式
 - 5.2.4 企业竞争现状
 - 5.2.5 市场布局分析
 - 5.2.6 产业面临挑战
- 5.3 芯片封装行业发展分析
 - 5.3.1 封装技术介绍
 - 5.3.2 市场发展现状

5.3.3 国内竞争格局

5.3.4 技术发展趋势

(1) 技术发展的多层次化

(2) 由单一的提供芯片封测方案向封测的完整系统解决方案转变

(3) 同比例缩小技术演化突破

5.4 芯片测试行业发展分析

5.4.1 芯片测试原理

5.4.2 测试准备规划

5.4.3 主要测试分类

5.4.4 发展面临的问题

5.5 芯片封测发展方向分析

5.5.1 承接产业链转移

5.5.2 集中度持续提升

5.5.3 国产化进程加快

5.5.4 产业短板补齐升级

5.5.5 加速淘汰落后产能

第六章 中国芯片产业下游应用市场分析

6.1 LED

6.1.1 全球市场规模

6.1.2 LED芯片厂商

6.1.3 主要企业布局

6.1.4 封装技术难点

6.1.5 LED产业趋势

6.2 物联网

6.2.1 产业链的地位

6.2.2 市场发展现状

6.2.3 物联网wifi芯片

6.2.4 国产化的困境

6.2.5 产业发展困境

6.3 无人机

6.3.1 全球市场规模

6.3.2 市场竞争格局

6.3.3 主流主控芯片

6.3.4 芯片重点应用领域

6.3.5 国产芯片发展方向

6.3.6 市场前景分析

6.4 北斗系统

6.4.1 北斗芯片概述

6.4.2 产业发展形势

6.4.3 芯片生产现状

6.4.4 芯片研发进展

6.4.5 资本助力发展

6.4.6 产业发展前景

6.5 智能穿戴

6.5.1 全球市场规模

6.5.2 行业发展规模

6.5.3 企业投资动向

6.5.4 芯片厂商对比

6.5.5 行业发展态势

6.5.6 商业模式探索

6.6 智能手机

6.6.1 市场发展形势

6.6.2 手机芯片现状

6.6.3 市场竞争格局

6.6.4 产品性能情况

6.6.5 发展趋势分析

6.7 汽车电子

6.7.1 市场发展特点

6.7.2 市场规模现状

6.7.3 出口市场状况

6.7.4 市场结构分析

6.7.5 整体竞争态势

6.7.6 汽车电子渗透率

6.7.7 未来发展前景

- (1) 安全系统电子技术
- (2) 主动安全电子技术
- (3) 被动安全电子技术
- (4) 车载电子系统技术

1) 智能导航系统

2) 车载信息系统

3) 自动汽车空调控制

- (5) 汽车电子系统趋势：智能化、网络化、集成化

1) 智能化：信息输入输出

2) 网络化：总线信息共享

3) 集成化：跨系统一体化

6.8 生物医药

6.8.1 基因芯片介绍

6.8.2 主要技术流程

6.8.3 技术应用情况

6.8.4 生物研究的应用

6.8.5 发展问题及前景

第七章 芯片行业领先企业经营分析()

7.1 芯片综合型企业案例分析

7.1.1 英特尔

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 技术工艺开发
- (5) 未来发展战略

7.1.2 三星

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 技术工艺开发

(5) 未来发展战略

7.1.3 高通公司

(1) 企业发展概况

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 技术工艺开发

(5) 未来发展战略

7.1.4 英伟达

(1) 企业发展概况

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 技术工艺开发

(5) 未来发展战略

7.1.5 AMD

(1) 企业发展概况

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 技术工艺开发

(5) 未来发展战略

7.2 芯片设计重点企业案例分析

7.2.1 博通有限公司

(1) 企业发展概况

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 收购动态分析

(5) 未来发展战略

7.2.2 Marvell

(1) 企业发展概况

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 收购动态分析

(5) 未来发展战略

7.2.3 赛灵思

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 收购动态分析
- (5) 未来发展战略

7.2.4 Altera

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 收购动态分析
- (5) 未来发展战略

7.2.5 Cirrus logic

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 收购动态分析
- (5) 未来发展战略

7.3 晶圆代工重点企业案例分析

7.3.1 格罗方德

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 产品研发进展
- (4) 技术工艺开发
- (5) 未来发展战略

7.3.2 Tower jazz

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 产品研发进展
- (4) 技术工艺开发
- (5) 未来发展战略

7.3.3 富士通

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构情况
- (4) 技术工艺开发
- (5) 未来发展战略

7.3.4 台积电

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 产品研发进展
- (4) 技术工艺开发
- (5) 未来发展战略

7.3.5 联电

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 产品研发进展
- (4) 技术工艺开发
- (5) 未来发展战略

7.4 芯片封测重点企业案例分析

7.4.1 Amkor

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.4.2 日月光

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.4.3 硅品

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.4.4 南茂

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业并购动态
- (4) 企业合作动态

7.4.5 长电科技

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.4.6 天水华天

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析

7.4.7 通富微电

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

7.4.8 士兰微

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

第八章中国芯片行业前景趋势预测与投资建议()

8.1 芯片行业发展前景与趋势预测

8.1.1 行业发展前景预测

(1) 芯片总体前景预测

(2) 芯片细分领域前景预测

8.1.2 行业发展趋势预测

(1) 行业市场发展趋势预测

1) 国产芯片已经取得突破，将会进一步发展

2) 行业整合加速

(2) 行业产品发展趋势预测

(3) 行业市场竞争趋势预测

8.2 芯片行业投资潜力分析

8.2.1 行业投资现状分析

8.2.2 行业进入壁垒分析

(1) 技术壁垒

(2) 人才壁垒

(3) 资金实力壁垒

(4) 产业化壁垒

(5) 客户维护壁垒

8.2.3 行业经营模式分析

8.2.4 行业投资风险预警

(1) 政策风险

(2) 宏观经济风险

(3) 供求风险

(4) 其他风险

8.3 芯片行业投资策略与建议

8.3.1 行业投资价值分析

(1) 行业发展空间较大

(2) 行业政策扶持利好

(3) 下游应用市场增长迅速

(4) 行业目前投资规模偏小

8.3.2 行业投资机会分析

(1) 宏观环境改善

(2) 政策的利好

(3) 产业转移

(4) 市场因素

8.3.3 行业投资策略分析

(1) 关于细分市场投资建议

(2) 关于区域布局投资建议

(3) 关于并购重组建议

图表目录：

图表 1：芯片产业链介绍

图表 2：截至2020年芯片行业标准汇总

图表 3：截至2020年芯片行业主要政策汇总

图表 4：截至2020年芯片行业发展规划

图表 5：2017-2022年我国GDP及同比增速（单位：万亿元，%）

图表 6：2017-2022年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速（单位：%）

图表 7：2020年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速（单位：%）

图表 8：2017-2022年全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）

图表 9：2017-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重（单位：%）

图表 10：2021年我国宏观经济指标预测（单位：%）

图表 11：2017-2022年年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数（单位：万户）

图表 12：“十三五”期间全国各区域R&D研究人员变化情况（单位：万人年）

图表 13：中国芯片行业发展机遇与威胁分析

图表 14：全球芯片行业发展历程

图表 15：2017-2022年全球芯片市场规模（单位：亿美元，%）

图表 16：2017-2022年全球半导体生产商（不含代工厂）排名TOP10（单位：十亿美元，%）

图表 17：2017-2022年英特尔与三星半导体业务营收对比及预测（单位：百万美元）

图表 18：2017-2022年全球芯片行业市场区域分布（单位：%）

图表 19：2020年全球芯片产品的下游应用占比（单位：%）

图表 20：2024-2030年全球芯片市场规模预测（单位：亿美元）

图表 21：2017-2022年美国芯片市场规模增长情况（单位：亿美元，%）

图表 22：2024-2030年美国芯片市场规模预测（单位：亿美元）

图表 23：日本半导体产业发展历程

图表 24：日本VLSI项目实施情况

图表 25：日本政府相关政策

图表 26：DRAM市场份额变化（单位：%）

图表 27：日本三大半导体开发计划的关联

图表 28：2017-2022年日本芯片市场规模增长情况（单位：亿美元，%）

图表 29：日本半导体设备厂商Top

图表 30：2024-2030年日本芯片市场规模预测（单位：亿美元）

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/416503.html>